

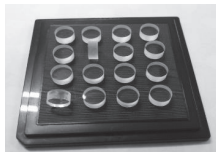
ダイシング加工の達人

切る

12インチまでのウエハの加工を一貫でお請けします 削る・切る・詰る・観る

—BG加工⇒ダイシング加工⇒トレー詰め⇒外観検査まで—

■超音波方式マシニングセンター導入
により円形加工に対応

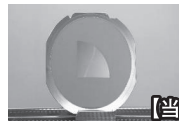


径：Φ1～Φ75mmまで
厚：お客様のご要望に対応

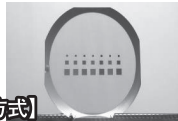
■12インチ対応裏面研削装置導入

シリコンウエハを5ミクロンまで削ります

- 既に薄いウエハでも更に薄くできます。
- 割れたウエハやチップでも薄くできます。



〔当社オリジナルのリング方式〕



ネブコン ジャパン2017 www.icp-expo.jp
第18回 半導体パッケージング技術展

小間NO.
W2-76

URL : <http://www.c-suntec.co.jp/>

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL042-557-7744(代) FAX042-557-7745



ダイシング加工の駆け込み寺
株式会社 **サンテック**
ISO9001、14001認証取得